Embedded Module

Open Standard Module™ - iesy ESP32 OSM-0F

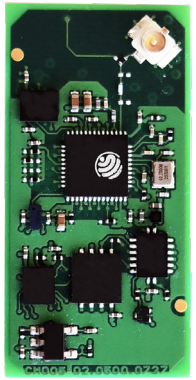
Technisches Konzept

- Microcontroller: ESP32 Xtensa DualCore x32 LX6
- CPU Clock Rate: 240 MHz
- Arbeitsspeicher: 512 KB
- Flash Speicher: 32 Mbit SPI-Flash
- Abmessung: 15 mm x 30 mm
- Footprint: OSM Size-0
  Land Grid Array (LGA) mit 188 Kontakten
- Spannungsversorgung: 3,3 V +/- 5 % über LGA Kontakten
- Leistungsaufnahme: <1 W (typ.)
- Temperaturbereich:
  > Im Betrieb: -40 °C bis +80 °C
  > Lagerung: -40 °C bis +85 °C
- Software: Espressif IDE (FreeRTOS basierend) via PlatformIO

- Funktionen & Schnittstellen

  > Wi-Fi 802.11 b/g/n + Bluetooth/BLE
  > 1 x LAN 10/100 (RMII), MAC kompatibel mit IEEE 802.3
  > 1x OSM Antenna-Contact / U.FL-Connector (Optional)
  > 1x SDIO-Card
  > 1x I2C
  > 2x ADC
  > 4x GPIO, 2x UART, 1x SPI

iesy GmbH I Meinerzhagen I Germany I +49 (2354) 70655 0 I sales@iesy.com I www.iesy.com



Über OSM™

Die Open Standard Module™ Spezifikation wurde 2019 von der SGeT e.V. verabschiedet. Der neue Standard wurde entwickelt, um zukünftigen Anforderungen in Bezug auf **Flexibilität, Skalierbarkeit**, aber auch der **Kostenreduktion** gerecht zu werden. OSM™-Auflötmodule können individuell an die jeweiligen Kundenanforderungen angepasst werden. Dazu können die einzelnen Module mittels Tray & Reel im **SMT-Prozess** automatisch verarbeitet werden. Die OSM™ Serie umfasst insgesamt vier verschiedene Formfaktoren.

iesy.com/osm